

上海市锦天城律师事务所
关于新恒汇电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（三）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

一、第二轮审核问询函之 1.关于智能卡业务成长性	5
二、第二轮审核问询函之 2.关于实际控制人借款.....	19
三、第二轮审核问询函之 3.关于关联交易.....	26
四、第二轮审核问询函之 5.关于主要客户紫光同芯.....	43

上海市锦天城律师事务所
关于新恒汇电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（三）

01F20204234-1-03

致：新恒汇电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新恒汇电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“新恒汇”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，担任发行人首次公开发行股票并上市工作（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所已出具《关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）等本次发行上市的申报文件。

2022年11月4日，深圳证券交易所上市审核中心下发了“审核函〔2022〕011041号”《关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“《第二轮审核问询函》”）。根据《第二轮审核问询函》的要求，本所特出具《上海市锦天城律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）对审核问询予以回复。

为出具本《补充法律意见书（三）》，本所声明如下：

1、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管

理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下简称“《执业细则》”）等规定及本《补充法律意见书（三）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书（三）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、发行人已向本所出具书面文件，确认其提供的所有文件原件均是真实、准确、完整的；所有复印件均与原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《补充法律意见书（三）》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他事项履行普通人一般的注意义务。

3、本《补充法律意见书（三）》仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规及本所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

4、本《补充法律意见书（三）》仅就法律问题陈述意见，并不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等非法律专业事项发表评论。本《补充法律意见书（三）》中涉及的会计、审计、资产评估、内部控制等内容，均严格按照有关中介机构出具的报告和发行人的有关文件引述。本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外，并不对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，并不作任何商业判断或发表其他方面的意见。

5、对于本《补充法律意见书（三）》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

6、本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适

用于本《补充法律意见书（三）》。本《补充法律意见书（三）》构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》的必要补充，应与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》一并理解和使用。《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》与本《补充法律意见书（三）》不一致的部分，以本《补充法律意见书（三）》为准。

7、除文义另有所指或特别说明外，本《补充法律意见书（三）》所使用的简称、词语的含义与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》相同。

8、本《补充法律意见书（三）》仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《补充法律意见书（三）》随发行人本次发行上市其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《补充法律意见书（三）》如下。

一、第二轮审核问询函之 1.关于智能卡业务成长性

申请文件及首轮问询回复显示：

（1）据欧洲智能卡行业协会统计数据，2019-2021 年全球智能卡的出货量分别为 100.33 亿张、95.40 亿张和 95.05 亿张，2020 年和 2021 年同比下滑比例分别为 4.91%和 0.37%，呈现略微下滑的趋势。

（2）2019-2021 年，全球电信 SIM 卡出货量均在 50 亿张左右，占智能卡总发卡量 50%左右；全球银行芯片卡出货量均在 35 亿张左右，由于中国与部分发达国家移动支付的普及，银行芯片卡发行量呈现逐年下降趋势。

（3）报告期各期，发行人境内销售收入占比分别为 98.18%、87.01%、80.26%和 80.24%。

公开信息显示，2011 年起，中国各大银行逐步将磁条银行卡替换成更加安全的金融 IC 卡；2017 年起，第二代社保卡开始替换第一代社保卡，并在 2018 年启用电子社保卡。

请发行人：

（1）按照电信 SIM 卡、银行芯片卡、社保卡等智能卡分类及行业政策，说明各类型智能卡国内市场容量、替换进展、发行人市场份额占比等情况，并结合目前微信、支付宝等线上支付方式及电子社保卡广泛使用的背景下，进一步充分论证智能卡市场空间是否受到挤压，行业发展前景是否存在重大不利变化，发行人业务的成长性。

（2）说明发行人有关虚拟卡技术及人才储备情况、业务布局、市场竞争情况等，并结合上述情况说明发行人竞争优势及是否存在技术迭代风险。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复：

（一）按照电信 SIM 卡、银行芯片卡、社保卡等智能卡分类及行业政策，说明各类型智能卡国内市场容量、替换进展、发行人市场份额占比等情况，并结合目前微信、支付宝等线上支付方式及电子社保卡广泛使用的背景下，进一步充分论证智能卡市场空间是否受到挤压，行业发展前景是否存在重大不利变

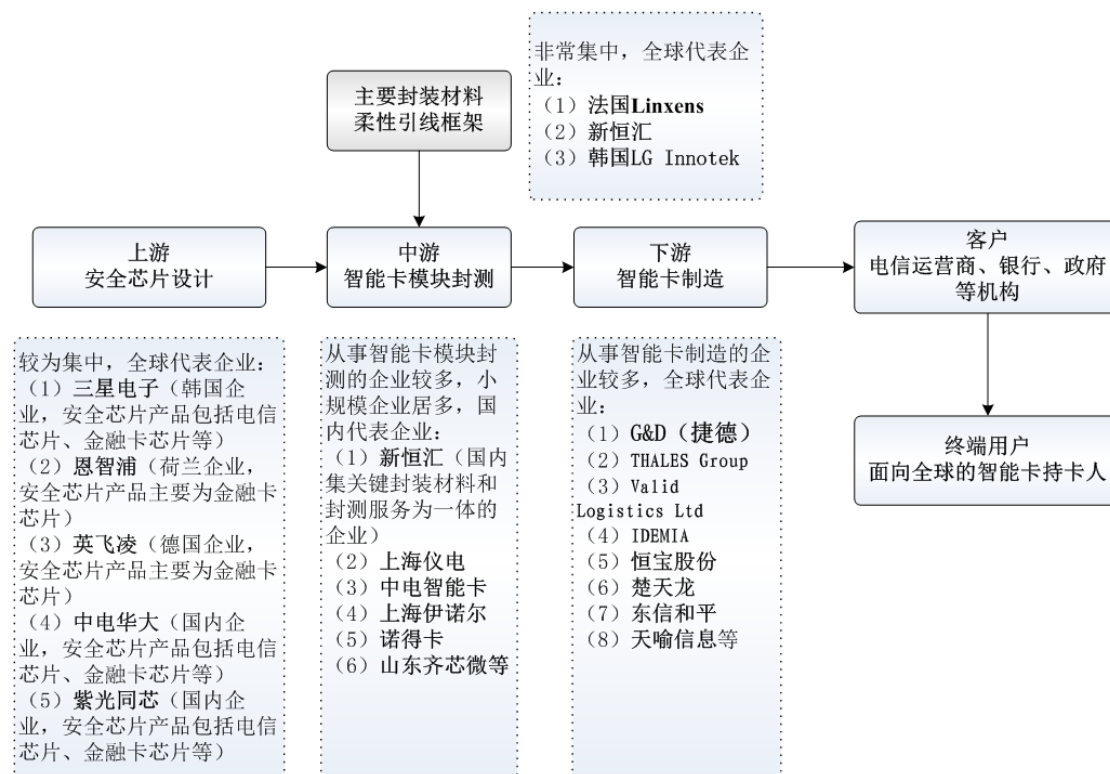
化，发行人业务的成长性

1、智能卡的全球及国内市场容量情况

（1）按直接客户口径统计，报告期内发行人的境内销售收入占比均在 80% 以上，但从最终用户口径看，发行人智能卡产品被下游客户销往全球各地

智能卡广泛应用于移动通信、金融支付、公共事业等多个领域，市场需求量大，终端使用客户遍布全球，不具有明显的区域性。近年来，全球智能卡市场细分化趋势明显，行业基本格局已经确定。行业上游是智能卡安全芯片设计厂商，行业中游为智能卡模块封测厂商，行业下游为智能卡制造厂商，行业终端用户为面向全球的智能卡使用者。

全球智能卡产业链的主要企业情况如下：



新恒汇处于产业链中游，为上游安全芯片设计厂商和下游智能卡厂商提供关键封装材料柔性引线框架产品和智能卡模块封测服务。上述产业链中上游安全芯片厂商中电华大和紫光同芯均为公司的主要客户之一，产业链下游的主要智能卡制造商大多为公司的重要客户。

从终端应用看，发行人对外销售的柔性引线框架和智能卡模块产品除了满足

中国境内市场需求外，大量的智能卡产品出货到海外市场，包括欧洲、东南亚、非洲和南美等地区，据估计，发行人至少有 50% 以上的产品最终销往海外市场。

由此而知，虽然报告期内发行人的智能卡产品对境内客户的直接销售占比较高，但是这些产品的最终客户并不局限在境内。此外，随着发行人在全球市场竞争力的进一步增强，以及未来发行人对海外下游客户（IDEMIA、Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH、THALES DISFRANCE SAS 等）直接销售收入的增加，发行人在全球市场的占有率也在持续提升。

因此，智能卡全球市场的容量更能反映发行人所面临的市场空间。

（2）全球智能卡市场容量及变化情况

根据全球权威机构欧洲智能卡行业协会发布的数据，近年来全球智能卡出货量数据变化情况如下：

单位：亿颗

类别	2022 年度（预计）	2021 年度	2020 年度	2019 年度
电信 SIM 卡	46.00	49.00	51.00	52.00
金融 IC 卡	32.00-33.00	32.50	31.70	33.50
证件卡等其他智能卡	14.40-14.60	13.55	12.70	14.83
合计	92.40-93.60	95.05	95.40	100.33

据欧洲智能卡行业协会预计，2022 年全球智能卡出货量为 92.40-93.60 亿颗，其中电信 SIM 卡出货量同比略降，金融 IC 卡出货量较 2021 年基本持平，证件卡等其他智能卡出货量略有增加，但整体保持相对稳定。

据另一家美国权威数据统计机构 ABI research 发布的全球智能卡与智能终端细分市场需求量的统计数据，ABI research 预计 2022~2025 年智能卡安全芯片及智能卡终端与设备需求量复合增长率为 3.81%，呈现小幅增长态势。

电信 SIM 卡市场方面，随着中国、印度等人口大国的手机普及率提高，全球电信 SIM 卡的需求量趋于稳定。受 5G 手机的普及（5G 业务需要更新 SIM 卡）、智能移动终端（如无线刷卡 POS 机）、具有更高安全要求的安全支付手机 SIM（NFC controller）的普及等因素影响，预计全球电信 SIM 卡的需求量仍将维持在每年 50 亿张左右。欧洲智能卡行业协会预测的 2022 年电信 SIM 卡出货量同比略有下降，主要是因为 2021 年下半年以来全球晶圆厂产能紧张，电信 SIM 卡

芯片单位价值较低，很难拿到晶圆厂足够的产能，导致市场上电信 SIM 卡芯片供应不足，出货量下降。2022 年二季度以来，随着上游晶圆产能紧张的缓解，电信 SIM 卡的出货量也在增长，全年电信 SIM 卡出货量有望接近 50 亿颗。

金融 IC 卡市场方面，根据欧洲智能卡行业协会的统计数据，2019~2022 年（预计）的全球出货量均在 30-35 亿张之间，近年来全球金融 IC 卡的需求量总体稳定。

其他智能卡方面，各国政府发行的身份证件，包括身份证、护照、港澳通行证等应用会相对稳定。各类行业应用类卡片，包括公交、社保、电子门禁、会员储值、校园卡等依然有发展空间。

总体来看，最近几年，全球智能卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。据欧洲智能卡行业协会预测，未来几年，全球智能卡的出货量会基本维持稳定。而据 ABI research 的市场研究数据，未来几年，智能卡安全芯片及智能卡终端的市场需求是小幅上涨的。

因此，结合上述分析，预计 2022 年及未来几年全球智能卡出货量总体保持稳定，不会出现大幅下滑的情形。

（3）国内智能卡市场容量及变化情况

由于国内缺乏权威的统计数据，发行人根据相关数据简单测算了国内智能卡的市场容量，具体情况如下：

A、电信 SIM 卡市场

经过多年的快速发展，国内手机已基本普及。国内每年新增的 SIM 卡市场，主要来源于新用户入网或者转网、用户补办、5G 业务升级、插拔式物联网终端需求等，每年的需求量相对稳定。电信 SIM 卡的需求量大小跟人口基数息息相关。截至 2021 年末，中国人口数量超过 14 亿，全球人口数量超过 78 亿，国内人口数量占全球人口数量的比重约为 17.95%。2021 年全球电信 SIM 卡市场的需求量为 49.00 亿张，按照人口占比测算，2021 年国内电信 SIM 卡市场的需求量约为 8.80 亿张。

B、银行芯片卡市场

根据中国人民银行和中国银行业协会发布数据，截至 2021 年末，全国共开

立银行卡 92.47 亿张，同比增长 3.26%，其中借记卡 84.47 亿张，信用卡和借贷合一卡 8.00 亿张；2021 年国内新增银行卡 2.7 亿张（不含挂失补办与到期更换新卡的数量）。信用卡和借贷合一卡有效期一般为 3-5 年，借记卡有效期一般为 10 年，到期必须更换，因此，2017 年新增的 1.23 亿张信用卡和借贷合一卡需要在 2021 年到期更换（取中间值按 4 年有效期计），2011 年新增的 4.79 亿张借记卡需要在 2021 年到期更换，2021 年国内银行卡到期更换新卡的测算总数约为 6.02 亿张。

基于上述测算数据，在不考虑挂失补办新卡的情况下，2021 年国内银行卡的需求量以当年新增银行卡与到期更换新卡数合计约为 8.72 亿张，占全球银行卡需求量的比重为 27%左右。

C、社保卡及其他智能卡市场

根据人社部发布的数据显示，截至 2022 年 9 月底，我国社保卡持卡人数达到 13.65 亿人，电子社保卡领用人数超过 6.4 亿。我国社保卡发展到 2022 年，已经经历了三代，第三代社保卡可以支持非接触刷卡，具有更强的金融安全性，可以与银行账户关联。最近几年，国内每年新增的社保卡主要来源于升级换卡，其他来源包括丢失补办及新增申领等。

国内自 2021 年开始推广第三代社保卡，假设 2024 年完成第三代社保卡的普及，按照社保卡持卡人数 13.65 亿和每年 1/4 的平均更换进度测算，不考虑丢失补办及新增申领的情况下，2021 年至 2024 年期间，国内社保卡的年需求量约为 3.41 亿张。

其他智能卡主要包括身份证、公交卡、加油卡、会员储值卡、校园卡等，每年新增发卡的需求量相对不大，由于缺少相关统计数据，不再单独进行测算。

据上述分析，国内每年的智能卡需求量主要来源于电信 SIM 卡、银行芯片卡及社保卡等领域，通过简单测算，2021 年国内智能卡需求量约为 20.93 亿张（包括电信 SIM 卡 8.80 亿张，银行芯片卡 8.72 亿张及社保卡 3.41 亿张），占全球市场的比重约为 22.02%。由于国内智能卡行业已经进入发展成熟期，预计未来几年，市场需求量相对稳定。

2、国内电信 SIM 卡、银行芯片卡、社保卡的替换进展

（1）国内电信 SIM 卡的替换进展

随着移动通信技术发展，SIM 卡也在不断进化演进，从第一代 SIM 卡目前已经演变到 5G SIM 卡，通信技术的每一次升级换代都带来用户更换 SIM 卡的热潮。未来电信 SIM 卡存在两大并行的发展趋势。一是适用手机终端可插拔的 SIM 卡，可以存储通讯录和运营商及用户身份信息数据；近年来，手机 SIM 卡也在拓展新的功能，比如可以部分替代手机存储器的大容量 SIM 卡，以及具有高性能金融支付能力的超级 SIM 卡。二是物联网中大量应用的嵌入式 SIM（eSIM）卡，eSIM 卡直接焊接在设备的电路板上，比起可插拔的 SIM 卡更牢靠，能耐高低温、抗震、防尘，同时支持通过空中写卡对 eSIM 卡进行远程配置，可灵活选择运营商网络。

目前国内市场上，插拔式 SIM 卡仍是市场主流，eSIM 卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备（如共享单车）、有远程联网通讯需求的公共电子设施或者终端设备中，尚未在手机市场推广使用，预计未来很长一段时间内，插拔式 SIM 卡和嵌入式的 eSIM 卡将并存发展。

（2）国内银行芯片卡的替换进展

2011 年起，中国人民银行在国内全面启动金融 IC 卡应用推广工作，各大商业银行逐步将磁条银行卡替换成更加安全的金融 IC 卡（银行芯片卡）。相比于磁条银行卡，金融 IC 卡不易被伪造、盗刷，安全性高，且支持非接触式支付，更加便捷。

为继续配合金融 IC 卡推广工作，中国人民银行要求各商业银行自 2015 年 1 月 1 日起逐步停止新发纯磁条介质的银行卡，对于已发行的存量纯磁条介质银行卡，要求积极引导持卡人换发芯片卡。

截至 2021 年末，全国金融 IC 卡累计发行 64.5 亿张左右，占银行卡总数的比例为 70%左右。

（3）国内社保卡的替换进展

2017 年起，中国第二代社保卡开始替换第一代社保卡，并在 2018 年启用电子社保卡。2022 年以来，国内社保卡已经发展到第三代。

近年来，电子社保卡被广泛使用，电子社保卡与实体社保卡一一对应，电子

社保卡的使用并未减少实体社保卡的数量，只是增加了持卡人的使用渠道，提高了使用便捷性，持卡人可根据应用场景和个人偏好选择使用实体卡或电子卡。

3、按下游应用划分的产品销量及市场占有率情况

由于发行人智能卡业务的主要产品柔性引线框架和智能卡模块大多是标准化产品，终端用户面向全球市场，无法准确区分哪些产品销往国内市场或海外市场，且国内市场并无权威、完整的市场容量数据，故下面以欧洲智能卡行业协会统计的全球智能卡市场容量为依据分析发行人市场占有率情况。

报告期各期，发行人按下游应用划分的产品销量及市场占有率情况如下：

单位：亿颗

产品	下游应用领域	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		销量	市场占有率	销量	市场占有率	销量	市场占有率	销量	市场占有率
柔性 引线 框架	电信 SIM 卡	9.70	42.17%	16.00	32.65%	15.90	31.18%	10.52	20.23%
	银行芯片卡、社保卡	1.95	12.00%	3.38	10.40%	2.74	8.64%	4.08	12.18%
	其他	0.10	1.38%	0.72	5.31%	0.38	2.99%	0.56	3.78%
	小计	11.75	25.27%	20.10	21.15%	19.02	19.94%	15.16	15.11%
智能 卡模 块	电信 SIM 卡	6.63	28.83%	12.42	25.35%	10.39	20.37%	5.57	10.71%
	银行芯片卡、社保卡	1.31	8.06%	1.85	5.69%	1.56	4.92%	2.68	8.00%
	其他	0.16	2.21%	0.92	6.79%	0.50	3.94%	0.49	3.30%
	小计	8.10	17.42%	15.19	15.98%	12.45	13.05%	8.74	8.71%

注 1：为了更准确的测算市场占有率，柔性引线框架的销量含发行人自产柔性引线框架用于智能卡模块封测的部分，智能卡模块的销量含封测服务部分形成的产品；

注 2：银行芯片卡和社保卡中使用的柔性引线框架和智能卡模块均为双界面产品，且社保卡也具备金融属性可刷卡支付，无法进一步细分，因此合并计算，在计算市场占有率时，基数为全球金融 IC 卡的需求量；

注 3：2022 年 1-6 月市场容量按全年预计数中值的一半来测算。

（1）柔性引线框架产品的市场份额占比

报告期各期，发行人应用于电信 SIM 卡的柔性引线框架产品销量（含用于智能卡模块封装实现间接销售的部分）分别为 10.52 亿颗、15.90 亿颗、16.00 亿颗和 9.70 亿颗，市场份额占比分别为 20.23%、31.18%、32.65%和 42.17%，产品

销量和市场份额占比逐年提高，在电信 SIM 卡芯片封测业务领域，发行人的竞争优势比较明显。

报告期各期，发行人应用于银行芯片卡、社保卡的柔性引线框架产品销量（含用于智能卡模块封装实现间接销售的部分）分别为 4.08 亿颗、2.74 亿颗、3.38 亿颗和 1.95 亿颗，市场份额占比分别为 12.18%、8.64%、10.40%和 12.00%。2019 年发行人应用于银行芯片卡、社保卡的柔性引线框架产品销量和市场占有率较其他年份高，主要原因是 2019 年全国推广 ETC，发行人把握时机，快速抢占 ETC 卡（属于金融 IC 卡类别）市场，获得较大销售量，而该等需求为短期需求，2020 年以后国内 ETC 卡的销量明显减少。总体来说，发行人在银行芯片卡、社保卡领域市场份额占比并不高，可提升空间较大。

（2）智能卡模块产品的市场份额占比

报告期各期，发行人应用于电信 SIM 卡的智能卡模块产品销量分别为 5.57 亿颗、10.39 亿颗、12.42 亿颗和 6.63 亿颗，市场份额占比分别为 10.71%、20.37%、25.35%和 28.83%，产品销量和市场份额占比逐年提高。

报告期各期，发行人应用于银行芯片卡、社保卡的智能卡模块产品销量分别为 2.68 亿颗、1.56 亿颗、1.85 亿颗和 1.31 亿颗，市场份额占比分别为 8.00%、4.92%、5.69%和 8.06%，可提升空间较大。2019 年该产品销量和市场份额占比与其他年份相比较为高，主要是如前所述 2019 年发行人把握住国内推广 ETC 市场机会，增加了产品销量。

4、按下游应用划分的智能卡业务销售收入情况

报告期各期，发行人按下游应用划分的智能卡业务销售收入情况如下：

单位：万元

下游应用 领域	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
电信 SIM 卡	12,145.32	54.41%	22,576.90	54.84%	22,923.20	61.52%	16,225.64	39.57%
银行芯片卡、社保卡	9,529.70	42.69%	15,428.10	37.47%	12,705.04	34.10%	22,784.54	55.57%
其他	647.15	2.90%	3,167.28	7.69%	1,631.58	4.38%	1,991.44	4.86%
合计	22,322.18	100.00%	41,172.27	100.00%	37,259.83	100.00%	41,001.62	100.00%

在电信 SIM 卡应用领域，报告期各期发行人智能卡业务的收入占比分别为 39.57%、61.52%、54.84%和 54.41%。最近两年及一期，该领域收入占比均超过 50%，是智能卡业务最主要的收入来源之一。2020 年，全球最大的安全芯片厂商韩国三星宣布退出部分低端电信 SIM 卡芯片市场，导致该市场需求的订单大量转移到国内主要安全芯片厂商中电华大与紫光同芯，而中电华大和紫光同芯均为公司的主要客户，因此 2020 年以来，发行人在电信 SIM 卡应用领域的市场占有率逐年增加，销售收入也较 2019 年有明显提升。最近两年及一期，发行人在电信 SIM 卡应用领域的产品销售收入基本保持稳定。

在银行芯片卡、社保卡应用领域，结合前述分析，虽然发行人在该应用领域的市场占有率较低，产品销量也远低于电信 SIM 卡应用领域，但银行芯片卡、社保卡应用的柔性引线框架和智能卡模块均为双界面产品，而电信 SIM 卡应用的柔性引线框架和智能卡模块均为单界面产品，双界面产品的材料成本高，生产工艺复杂，因此其销售价格也远高于单界面产品，通常一个双界面产品的售价大约为单界面产品的 4 倍左右。

报告期各期，发行人在银行芯片卡、社保卡应用领域的产品销售收入分别为 22,784.54 万元、12,705.04 万元、15,428.10 万元和 9,529.70 万元，2019 年发行人在该领域的产品销售收入比其他年份高，主要原因如前所述，系 2019 年发行人把握住国内推广 ETC 市场机会，增加了产品销量。从最近两年及一期的销售情况来看，发行人在银行芯片卡、社保卡应用领域的竞争力在逐渐增强，产品销量、市场占有率和销售收入均呈现稳步增加的态势，2021 年发行人在该领域的业务收入同比增长 21.43%，2022 年 1-6 月，发行人在该领域的业务收入已达到 9,529.70 万元，预计全年继续保持较快的增长速度。

因此，发行人在银行芯片卡、社保卡应用领域的产品市场占有率逐年提升和销售收入的增加，将是体现公司智能卡业务成长性的重要点之一。

5、结合目前微信、支付宝等线上支付方式及电子社保卡广泛使用的背景下，进一步充分论证智能卡市场空间是否受到挤压，行业发展前景是否存在重大不利变化，发行人业务的成长性

微信、支付宝等线上支付方式及电子社保卡广泛使用并未明显挤压实体智能卡市场空间，行业发展前景未因此发生重大不利变化，具体分析如下：

（1）微信、支付宝等线上支付方式减少了银行卡的使用次数，但电子化支付均需绑定实体银行卡并进行实名认证后方可交易，并未导致实体银行卡数量的减少

近年来国内通过手机使用微信与支付宝刷码支付广泛普及，极大地代替了现金与实体银行卡（含储值卡与信用卡）的使用。刷码支付也是银行卡或者现金的一种电子化应用，但它并不能真正取代银行卡和现金的发行。用户使用手机进行支付与转账时，实际是将自己银行卡账户或者手机钱包中的现金转移到了收款方的银行卡账户或者手机钱包中。如果支付与收款双方没有银行卡账户或者手机钱包，支付就不能完成。

微信和支付宝等电子支付方式虽然在国内普及率较高，但由于支付体系、消费观念及移动互联网络覆盖率等方面的差异导致移动支付在海外市场并未形成广泛的用户基础。其次，电子二维码等支付方式安全性难以得到足够的保障，无法像银行卡一样获取 VISA、MASTER、中国银联等国际支付机构所认可的国际安全标准认证，在不同发卡银行、不同收款银行及不同国家之间难以得到广泛的应用支持。再次，中国境内电子支付的流行，实际上并没有带来银行卡数量的下降，而只是减少了实体银行卡的使用频次。

因此，国内银行卡的发展趋势是实体芯片卡和电子支付相互促进，协同发展。

（2）电子社保卡与实体社保卡一一对应，电子社保卡的普及，对实体社保卡的发行量不会造成冲击

在社保卡领域，国内目前也在推行电子社保卡。电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应，由全国社保卡平台统一签发，人力资源和社会保障部统一管理。与实体社保卡一样，电子社保卡全国统一、全国通用，具有身份凭证、信息记录、自助查询、缴费及待遇领取、金融支付等功能，是持卡人线上享受人社服务及其他政府民生服务的电子凭证和结算工具。

虽然电子社保卡使用的便捷性会导致实体社保卡现场应用频次减少，但是电子社保卡并不能取代实体社保卡，申领电子社保卡，得先持有实体社保卡且处于正常状态。因此电子社保卡的普及，对实体社保卡的发行量不会造成冲击。

基于以上分析，发行人所处的智能卡行业发展前景并未发生重大不利变化，

预计未来几年全球智能卡市场每年需求量仍将维持在 90-100 亿张左右。

考虑到以下几点，发行人的智能卡业务具备成长性：

首先，从市场占有率方面看，根据欧洲智能卡行业协会发布的行业权威统计数据，最近三年全球智能卡总出货量分别为 100.33 亿张、95.40 亿张、95.05 亿张，虽然市场容量基本保持稳定，但据此测算发行人最近三年智能卡业务中柔性引线框架产品市场占有率分别为 15.11%、19.94%和 21.15%，智能卡模块产品的市场占有率分别为 8.63%、12.15%和 14.79%，均呈现逐年增长的态势，且依然存在较大的提升空间。

其次，从收入规模和细分产品增速方面看，2021 年，发行人智能卡业务收入为 41,172.27 万元，同比增长 10.50%；2022 年 1-6 月，发行人智能卡业务收入达到 22,322.18 万元，且 2022 年下半年智能卡业务经营情况良好，产能和订单同步增加，预计 2022 年发行人智能卡业务收入同比继续保持增长。从最近两年及一期的细分产品销售情况来看，发行人在银行芯片卡、社保卡应用领域的竞争力在逐渐增强，产品销量、市场占有率和销售收入均呈现稳步增加的态势，2021 年发行人在该领域的业务收入同比增长 21.43%，2022 年 1-6 月，发行人在该领域的业务收入已达到 9,529.70 万元，预计全年继续保持较快的增长速度。因此，发行人在银行芯片卡、社保卡应用领域的产品市场占有率逐年提升和销售收入的增加，将是体现公司智能卡业务成长性的重要点之一。

再次，如公司《招股说明书》等已披露的，发行人在智能卡业务领域深耕多年，具备较强的竞争优势，包括集关键封装材料和封测服务于一体的经营模式、核心技术优势、产品性价比优势、工艺技术优势、积累了大量全球行业内的优质客户等。

综上，虽然全球智能卡市场已进入发展成熟期，市场需求量相对稳定，但考虑到发行人的竞争优势明显，市场占有率逐年提升，且总体市场占有率并不高，尤其是在银行芯片卡、社保卡等应用领域，发行人的竞争力在逐渐增强，产品销量、市场占有率和销售收入均呈现稳步增加的态势，且可提升空间很大，因此，发行人的智能卡业务具备成长性。

（二）说明发行人有关虚拟卡技术及人才储备情况、业务布局、市场竞争

情况等，并结合上述情况说明发行人竞争优势及是否存在技术迭代风险

关于“虚拟卡”的含义，在电信卡领域，主要是指嵌入式 SIM（eSIM）卡；在金融卡、社保卡、身份认证等领域有两层含义：一是指实体卡的电子化应用，比如电子身份证、电子社保卡；二是指金融领域的“无卡账户”，它真正脱离了实体卡。

1、关于电信卡领域的虚拟卡说明

目前国内市场上，插拔式 SIM 卡仍是市场主流，eSIM 卡主要用于可穿戴设备、移动电子设备（比如共享单车）、有远程联网通讯需求的公共电子设施或者终端设备中，尚未在手机市场推广使用。预计未来很长一段时期内，插拔式 SIM 卡和嵌入式的 eSIM 卡将并存发展。

为应对上述发展趋势，发行人自 2019 年开始投入物联网 eSIM 芯片封测相关技术的研发，2020 年物联网 eSIM 芯片封测实现了小批量生产，2021 年物联网 eSIM 芯片封测业务实现销售收入 1,665.12 万元。SIM 卡和 eSIM 封测业务的客户群体存在一定重叠，发行人未来可以很好的承接因 SIM 卡转向 eSIM 而转移的订单需求。

在 eSIM 芯片封测方面，发行人已经掌握了相关核心技术，具备了大批量生产能力，并积累了一批优质客户，具有一定的先发竞争优势。

2、关于金融卡、社保卡、身份认证领域的虚拟卡说明

“无卡账户”是一种比较超前的概念。它不需要主管机构发行实体卡，而只是发给客户一个以一串数字为代表的银行账户（类似于现在的虚拟货币账户），用户不需要以实体卡作为个人身份认证的直接载体。由于缺乏足够安全及国际通用的安全数字标准，没有权威发行机构为账户信用背书，“无卡账户”目前在国际上难以得到不同银行之间的互认，其成熟周期尚无法预计，对实体卡市场的冲击在可预计的周期内可以忽略。

目前较为常见的是实体卡的电子化应用。近年来国内通过手机使用微信与支付宝刷码支付广泛普及，很大程度上降低了现金与银行卡（含储值卡与信用卡）的使用频率。但刷码支付也是银行卡或者现金的一种电子化应用，它并不能真正取代银行卡和现金的发行。电子支付的普及，不会冲击银行卡的发行量。此外，

从 2018 年 12 月起，央行规定每个客户只能在一家银行开设一个一类账户，这对银行卡的发卡量造成一定的不利影响，但目前在一家银行有多个一类账户的现象已基本清理完毕，对实体卡发行数量的不利影响已基本消除。

近年来央行在大力推行数字化货币。数字化货币的发行，可以取代现金货币的发行量。但是数字化货币目前采用的“钱包”，包括了实体钱包与数字钱包两种模式。实体钱包依然采取了类似于银行卡的一个实体卡片，数字钱包由各银行 app 负责数字安全问题。因此，数字钱包广泛推行时，还会增加实体钱包的银行卡发行量。

在社保卡领域，国内目前也在推行电子社保卡。电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应，申领电子社保卡，得先持有实体社保卡且处于正常状态。因此，实体社保卡现场应用频次会减少，但实体社保卡并不会被取代，电子社保卡的普及，对实体社保卡的发行量不会造成冲击。

在身份验证领域，国内在推行电子身份证。在核验身份的时候，不需要出示实体身份证，而仅需要出示电子化的身份证。而电子身份证的颁发，是由权威机构（主要是公安机构）根据用户真实的身份，与实体身份证一一对应，经过核验后，发给一个经过加密并可以随时核验的电子化凭证。

此外，近年来手机公交卡也在逐步普及。手机公交卡的核心是集成了 NFC 功能的手机，通过华为钱包、支付宝等中间技术服务者，与各地公交卡公司达成紧密合作，在手机 NFC 中将达成合作的公交卡公司的密钥初始化到 NFC 的加密存储区，使其具有实体卡片的功能。这类应用比较适合于公交卡这类小额应用、频繁使用、有城市一卡通这样有统一发卡与结算单位的情况，并不适用于电信、金融、社保、身份证照等重要应用领域。

智能卡电子化应用的趋势虽不可逆，但电子化主要是简化了用卡的方式，卡片使用更加方便快捷，并不会大量取代实体卡，给智能卡行业带来重大不利变化的可能性较低，不会导致发行人的持续经营能力存在重大不确定性。实体智能卡与电子化交易协同发展符合行业的发展特点，将成为智能卡行业中长期的发展模式。

综上所述，电子化身份认证、电子社保卡、电子支付中的“虚拟卡”更多的

是指实体卡的电子化应用场景。“虚拟卡”的发行与验证，其核心技术是区块链技术、数字加密与认证、数字传输、数字比对、数据库检索等相关的底层技术，已经脱离了集成电路的领域，也超出了发行人的核心技术领域。

因此，发行人还是聚焦在实体卡芯片的封装服务与封装材料领域，并未在金融卡、社保卡、身份认知等虚拟卡方面进行布局。

（三）核查方式

1、查阅欧洲智能卡行业协会公布的 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年（预计）智能卡出货量数据，了解全球智能卡行业的发展趋势；

2、通过公开信息检索全球智能卡产业链主要企业的基本情况；

3、查阅 ABI research 在 2022 年发布的全球智能卡与智能终端细分市场需求量的统计数据；

4、查阅发行人出具的关于中国三大电信运营商近年来每年采购 SIM 卡（包含物联网 eSIM 模块）数量的统计说明；

5、查阅中国人民银行和中国银行业协会发布的关于银行芯片卡的发行数据和人社部发布的关于社保卡持卡人数的数据；

6、访谈发行人董事长，进一步了解智能卡行业的市场竞争格局、发行人的竞争优势和劣势及发行人智能卡业务的未来成长性；

7、通过公开渠道，查阅虚拟卡、智能卡电子化趋势的相关研究报告或报道，了解智能卡行业实体智能卡与电子卡协同发展的趋势。

（四）核查意见

综上，本所律师认为：

1、全球智能卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势，未来几年，预计全球智能卡出货量总体保持稳定，不会出现大幅下滑的情形；微信、支付宝等线上支付方式及电子社保卡广泛使用并未明显挤压实体智能卡市场空间，行业发展前景未因此发生重大不利变化；鉴于发行人最近两年智能卡业务的收入增长情况、市场地位、竞争优势，发行人智能卡业务的市场占有率逐年提高，且仍有较大的提升空间等，发行人的智能卡业务具有成长性。

2、在 eSIM 芯片封测方面，发行人已经掌握了相关核心技术和具备了大批量生产能力，并积累了一批优质客户，具有一定的先发竞争优势；在金融卡、社保卡、身份认证等电子化应用领域，“虚拟卡”已经脱离了集成电路的领域，也超出了发行人的核心技术领域，发行人聚焦在实体卡芯片的封装服务与封装材料领域，并未在金融卡、社保卡、身份认知等虚拟卡方面进行业务或相关技术布局。

二、第二轮审核问询函之 2.关于实际控制人借款

申请文件及首轮问询回复显示：

（1）虞仁荣、任志军为发行人的控股股东及共同实际控制人，两人分别合计持有发行人 31.96%、19.31%的股份。任志军于 2018 年 1 月受让新恒汇有限 22.57%的股权时的 11,625.00 万元来源于虞仁荣提供的借款，其他直接或间接持有的发行人的股权为其自有资金出资。

（2）2018 年 1 月 25 日，虞仁荣与任志军签署了《借款协议》，约定借款期限为五年，任志军可在借款期限届满三个月前提出延期归还，延期最长不超过 3 年，借款利率为 12%/年（单利）；2022 年 8 月 4 日，虞仁荣与任志军签署了《借款协议之补充协议》，将借款延期期限由最长不超过 3 年变更为最长不超过 6 年，最晚还款日为 2029 年 1 月 25 日。

请发行人：

（1）说明任志军截至目前的借款情况，是否存在其他大额未清偿债务、是否面临较大偿债风险，是否影响发行人实际控制权的稳定。

（2）结合任志军在发行人上市后股份减持的安排与承诺，说明发行人上市后稳定控制权的措施及有效性。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复：

（一）说明任志军截至目前的借款情况，是否存在其他大额未清偿债务、是否面临较大偿债风险，是否影响发行人实际控制权的稳定

1、任志军截至目前的借款情况，是否存在其他大额未清偿债务

经访谈任志军，截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，其现有债务情

况如下：

出借人	借款金额 (万元)	借款时间	借款期限	借款用途	双方关系	年利率 (单利)
虞仁荣	11,625.00	2018.1.26	5 年（到期可延期 6 年）	受让发行人股权	同学	12%
王龙声	100.00	2022.5.17	2 年	用于其他股权投资	朋友	6%

除上述对外借款外，任志军不存在其他大额未偿还债务；截至目前，任志军的财务状况良好，未发生到期无法偿还借款或逾期偿还借款的情况。

根据任志军的《个人信用报告》，其信用状况正常，不存在尚未结清的贷款。

经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网站，任志军无涉诉及执行信息，不存在作为失信被执行人的情形。

综上，截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，任志军共有两笔尚待偿还借款，其一为任志军于 2018 年 1 月向大学同学虞仁荣借款 11,625.00 万元，用于支付收购新恒汇有限 22.57% 股权的转让价款；其二为任志军于 2022 年 5 月向朋友王龙声借款 100.00 万元，用于其他项目的股权投资；除此以外，任志军不存在其他大额未清偿债务。

2、是否面临较大偿债风险，是否影响发行人实际控制权的稳定

（1）在可预见的较长期限内，任志军不存在重大偿债风险

根据任志军现有债务情况及相关协议约定，在可预见的较长期限内，其不存在重大偿债风险。

①根据虞仁荣与任志军签署的《借款协议》及《借款协议之补充协议》，虞仁荣向任志军提供的 11,625.00 万元借款最晚还款日为 2029 年 1 月 25 日，在借款到期日之前，任志军无需就借款还本付息，虞仁荣也无权要求任志军提前清偿债务。任志军和虞仁荣已确认上述借款目前尚未到期，任志军不存在因借款导致的已到期债务的重大偿债风险；虞仁荣未要求任志军以其持有发行人股份提供质押担保；虞仁荣与任志军之间不存在因前述借款及任志军持有的新恒汇的股权导致的任何纠纷或潜在纠纷。

②王龙声向任志军提供的 100.00 万元借款金额较小，任志军的薪资收入和其他个人资产足以覆盖该等债务。

因此，基于任志军当前的负债情况，在可预见的较长期限内（2029 年 1 月 25 日前），其不存在重大偿债风险，其持有的发行人股份不存在因重大偿债风险而被强制处置的风险，不会影响发行人实际控制权的稳定性。

（2）偿还大额债务的可行性测算

截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，任志军直接持有公司股份 29,116,000 股，通过宁波志林堂间接持有公司股份 5,572,638 股，共计持有公司股份 34,688,638 股，占发行前公司总股本的 19.31%，占发行后公司总股本的 14.48%（假设公司发行新股 5,988.8867 万股）。

任志军待偿还大额债务主要为虞仁荣提供的借款 11,625.00 万元本金及利息。

任志军持有的公司股份按照同类公司或可比公司市盈率计算的市场价值及对债务的覆盖情况如下：

项目	同类公司	可比公司
市盈率	36.65[注 1]	27.69[注 2]
发行人 2021 年度每股收益	0.56 元/股	
根据市盈率计算的发行人每股市场价格	20.52 元	15.51 元
任志军持有的公司股权市场价值	71,194.96 万元	53,784.73 万元
借款本金/任志军持有的公司股权市场价值	16.33%	21.61%
任志军持有的公司股权市场价值/借款本金	612.43%	462.66%

注 1：同类公司市盈率为截至 2022 年 11 月 4 日根据证监会行业分类与发行人同属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”的创业板 178 家上市公司的加权平均静态市盈率，数据来源于国证指数；

注 2：发行人可比公司法国 Linxens 未上市，无法获取市盈率数据；可比公司上海仪电为飞乐音响（600651.SH）子公司，2020 年起纳入飞乐音响合并范围，无法单独获取市盈率数据；故采用康强电子 2022 年 11 月 7 日收盘价除以 2021 年 12 月 31 日每股收益计算得出可比公司市盈率，数据来源于 Wind 资讯。

按上表所示，以截至 2022 年 11 月 4 日与发行人同属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”的创业板 178 家上市公司的加权平均静态市盈率和基于 2022 年 11 月 7 日收盘价的可比公司市盈率计算的任志军所持发行人股份的市场价值分别为 71,194.96 万元和 53,784.73 万元，对任志军大额借款本金的覆盖率分别为 612.43%和 462.66%。

假设发行人 2024 年年初挂牌上市，任志军持有的发行人的股票锁定 36 个月后自 2027 年年初起可以减持以偿还上述债务，根据同类公司或可比公司市盈率

测算任志军所持发行人股权价值和各年度债务清偿情况如下：

单位：万元

项目	使用同类公司市盈率计算			使用可比公司市盈率计算		
	2027 年	2028 年	2029 年	2027 年	2028 年	2029 年
期初本金金额	11,625.00	3,067.91	-	11,625.00	5,160.49	-
期初利息总额	12,555.00	4,708.35	-	12,555.00	6,968.33	-
期初任志军持有的全部公司股权市场价值	71,194.96	53,396.22	45,619.96	53,784.73	40,338.55	28209.73
当年通过减持最大筹措资金	17,798.74	7,776.26	-	13,446.18	12,128.82	-
期末任志军持股比例	10.86%	9.28%	9.28%	10.86%	7.59%	7.59%

注：基于谨慎性考虑，上述股权市场价值计算均未考虑发行人盈利的成长性。

①使用同类公司市盈率计算的任志军所持公司股权市场价值进行债务清偿的测算情况如下：

截至 2027 年年初（暂以实际出借日 2018 年 1 月 26 日起计算至 2027 年 1 月 25 日止，下同），任志军所欠虞仁荣借款本金金额为 11,625.00 万元，累计利息总额为 12,555.00 万元，使用同类公司市盈率计算的任志军持有的全部公司股权市场价值为 71,194.96 万元。考虑到任志军关于减持意向的承诺，其锁定期限届满后每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，任志军于 2027 年通过减持其所持有的发行人股份总数的 25%（最大减持量，下同）能够筹集的资金总额为 17,798.74 万元。根据《借款协议》约定，借款期内归还部分本金时应同时支付该笔本金对应的利息，假设对截至 2027 年 1 月 25 日的本息进行偿还，使用上述减持股份所筹集资金可偿还本金和利息分别为 8,557.09 万元和 9,241.65 万元。

截至 2028 年年初（暂以 2028 年 1 月 25 日计，下同），任志军所欠借款剩余本金金额和剩余利息金额分别为 3,067.91 万元和 4,708.35 万元（以未清偿本金及对应利息与初始借款本金在 2027 年 1 月 26 日至 2028 年 1 月 25 日期间产生的利息的合计值为预估数，下同），任志军当年需通过减持股份筹措的资金总额为 7,776.26 万元，上述金额所涉及的减持股份数未超过其所持有的发行人股份总数的 25%。至此，任志军所欠全部债务本息均可清偿完毕。债务清偿完毕后，

任志军所持发行人的股份比例由 14.48%下降为 9.28%（因 2028 年需减持股份数较少，故计算时未考虑当年度产生的借款利息；以 2028 年初剩余借款本金 3,067.91 万元计算新增利息最多不超过 368.15 万元，对任志军的减持股份数及期末持股比例影响较小；同时该测算未考虑其他变动因素，以下同）。

②使用可比公司市盈率计算的任志军所持公司股权市场价值进行债务清偿的测算情况如下：

截至 2027 年年初，任志军所欠借款本金金额为 11,625.00 万元，累计利息总额为 12,555.00 万元，使用可比公司市盈率计算的任志军持有的全部公司股权市场价值为 53,784.73 万元。考虑到任志军关于减持意向的承诺，其锁定期限届满后每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，任志军于 2027 年通过减持其所持有的发行人股份总数的 25%能够筹集的资金总额为 13,446.18 万元。假设对截至 2027 年 1 月 25 日的本息进行偿还，使用上述减持股份所筹集资金可偿还本金和利息分别为 6,464.51 万元和 6,981.67 万元。

截至 2028 年年初，任志军所欠借款剩余本金金额和剩余利息金额分别为 5,160.49 万元和 6,968.33 万元，任志军当年需通过减持股份筹措的资金总额为 12,128.82 万元，上述金额所涉及的减持股份数未超过其所持有的发行人股份总数的 25%。至此，任志军所欠全部债务本息均可清偿完毕。债务清偿完毕后，任志军所持发行人的股份比例由 14.48%下降为 7.59%（以 2028 年初剩余借款本金 5,160.49 万元计算新增利息最多不超过 619.26 万元，对任志军的减持股份数及期末持股比例影响较小）。

综上所述，发行人上市后，任志军的负债比率相对较低，其持有的股份市场价值大幅高于上述对外借款本息总额，财务状况良好。任志军在符合限售期及减持规则的前提下出售其持有的部分股票偿还向虞仁荣的借款本息具备可行性，不存在较大偿债风险。

经测算，发行人上市后，任志军出售其持有的部分发行人股票清偿上述债务，不影响任志军和虞仁荣二人对公司共同控制的实际情况，不会影响发行人实际控制权的稳定性。

（二）结合任志军在发行人上市后股份减持的安排与承诺，说明发行人上

市后稳定控制权的措施及有效性

为保证公司上市后控制权的稳定，公司及控股股东、实际控制人制定了维持公司控制权稳定性的相关措施，具体包括：

1、严格遵守股份限售和减持承诺，保证控制权稳定

控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股东已作出如下承诺及声明，以保证控制权稳定，维护公司的有效治理及规范运作：

（1）任志军、虞仁荣作出的关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺

鉴于对公司长期经营发展看好的信心，任志军、虞仁荣针对持有的公司首次公开发行股票前的股份已作出如下持股意向及减持意向承诺，即自发行人发行的股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托任何第三人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；锁定期届满后两年内减持股份的，按照中国证监会、深圳证券交易所规定的方式及程序减持，减持数量不超过相关限制性规定，在担任发行人董事/监事/高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其本人所持有发行人股份总数的 25%等，具体承诺事项已由发行人在《招股说明书》中完整披露。

任志军在符合限售期及减持规则的前提下通过减持部分股票偿还对外借款债务的可行性分析参见前文，在可预见的较长期限内，其不存在较大偿债风险；任志军减持股票的情况不影响其和虞仁荣对发行人的共同控制，不会影响发行人实际控制权的稳定性。

（2）武岳峰、淄博高新城投、淄博高新产投关于不谋求发行人实际控制权作出的声明

发行人单独或合计持股 5%以上的股东武岳峰、淄博高新城投、淄博高新产投已就不谋求发行人实际控制权出具声明：“不以单独或与第三方保持一致行动或其他方式谋求对新恒汇电子股份有限公司的实际控制权。”

基于实际控制人在发行人上市后股份锁定及股份减持的安排与承诺及其他持有发行人 5%以上股份的股东关于不谋求发行人实际控制权的声明，发行人上市后稳定控制权的措施真实有效。

2、任志军、虞仁荣通过签署一致行动协议保障发行人控制权的稳定性

公司共同实际控制人为虞仁荣、任志军，两人直接和间接持有公司股份比例合计为 51.27%，其中直接持股比例为 47.62%，可以实际支配发行人超过 30% 的股份表决权；二人在公司中分别担任董事、董事长等重要职务，共同控制公司。任志军和虞仁荣于 2021 年 3 月签署了《一致行动人协议》，约定在公司决策层面，对各项事项的表决意见均保持一致，协议有效期至公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年。上述《一致行动人协议》巩固了双方在公司中的控制地位，保障了发行人控制权的稳定性。

3、通过多种渠道合理安排资金偿还到期债务

任志军除持有发行人股份外，还拥有多种可处置的资产，包括但不限于房产、其他股权投资等，其可通过资产处置变现、银行贷款、公司上市后现金分红等多种方式筹措资金，保证偿债能力，具备按期对所负债务进行清偿的能力。

4、加强公司治理与内部控制建设

发行人不断健全公司治理体系、不断完善内部控制制度，严格遵守相关法律法规及内部规章制度，注重法人治理和内部控制制度的建设与完善，促进公司治理的制度化及规范化。

综上所述，发行人、控股股东、实际控制人及相关股东已采取措施，保证本次发行上市后发行人控制权的稳定性和公司治理运作的有效性。

（三）核查方式

1、核查任志军的资金流水，取得相关借款合同、借款凭证；

2、访谈任志军并取得其对债务情况的确认，了解对外负债的形成过程、债务到期时间及还款安排；

3、取得中国人民银行征信中心出具的信用报告、发行人所在企业登记管理机关出具的关于股权冻结情况的查询文件及任志军对个人信用情况的确认，并查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网站，核查任志军的个人信用情况、是否存在失信被执行记录、是否存在重大未完结的诉讼或仲裁，其所持有的公司股份是否存在诉讼或司法冻结等情形；

4、查阅任志军出具的调查表，通过国家企业信用信息公示系统、企查查等核查其股权投资资产情况；

5、就借款相关事项访谈虞仁荣及任志军，了解大额借款发生的背景及还款安排，核查任志军是否存在较大偿债风险，其持有的发行人股份是否因借款存在权利限制，并取得双方出具的承诺函；

6、查阅公司共同实际控制人虞仁荣、任志军签署的关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺和《一致行动人协议》，查阅公司股东武岳峰、淄博高新城投、淄博高新产投就不谋取实际控制权出具的声明。

（四）核查意见

综上，本所律师认为：

1、任志军不存在其他大额未清偿债务，在可预见的较长期限内，不存在较大偿债风险，不影响发行人实际控制权的稳定性。

2、发行人上市后，任志军通过减持部分解禁股票偿还对外借款债务具备可行性，不违反股份锁定及减持意向承诺，不存在较大偿债风险，不会影响发行人实际控制权的稳定性。

三、第二轮审核问询函之 3.关于关联交易

申请文件及首轮问询回复显示：

（1）2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，发行人向董事陈铎实际控制的山东齐桓智能设备有限公司（以下简称山东齐桓）采购金额分别为 125.54 万元、712.13 万元、47.52 万元。其中，发行人向山东齐桓采购的贴带机、退膜清洗机、表面清洗机平均采购单价分别为 41.00 万元/台、50.44 万元/台、41.15 万元/台，均低于从其他供应商 53.10 万元/台、55.75 万元/台、53.10 万元/台的平均采购单价。

（2）2020 年和 2021 年，发行人向其董事吕大龙担任董事的中山新诺科技股份有限公司（以下简称中山新诺）采购卷对卷双面数字化光刻设备，采购金额分别为 1,180.53 万元和 3,014.16 万元，采购均价分别为 590.27 万元/台、376.77 万元/台。

（3）发行人 LDI 设备供应商中山新诺是目前国内唯一一家拥有数字化光刻技术原始专利的设备制造商。

.....

请保荐人、发行人律师说明发行人与关联方之间是否存在经营同类业务的情形，如存在，请说明是否为对发行人构成重大不利影响的同业竞争，并发表明确意见。

回复：

（一）说明发行人与关联方之间是否存在经营同类业务的情形，如存在，请说明是否为对发行人构成重大不利影响的同业竞争，并发表明确意见

根据《招股说明书》、发行人出具的说明并经本所律师核查，发行人主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网 eSIM 芯片封测业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（已于 2022 年 8 月 12 日废止），发行人所处的行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”中的“集成电路制造业（C3973）、电子专用材料制造（C3985）”，具体细分行业为集成电路封装材料及封测服务业。

根据发行人控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员提供的调查表、确认函并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统及其他公开信息，发行人的关联方与发行人是否存在经营同类业务的情况如下：

1、发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的企业的业务情况

发行人控股股东、实际控制人控制的企业与发行人不存在经营同类业务的情形，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，详见《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中“审核问询函之 15.关于同业竞争”之回复。

经核查，发行人控股股东、实际控制人的近亲属不存在控制的其他企业，不存在与发行人经营同类业务的情形。

2、发行人其他关联方的业务情况

（1）报告期内发行人其他持股 5%以上股东及其控制的企业中从事的业务与半导体行业相关的企业及其业务情况如下：

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
1	国高微（淄博）半导体制造股份有限公司	与淄博高新城投合计持有发行人 5%以上的股东淄博高新产投曾经控制的公司	一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	目前为淄博高新产投实际控制的设备采购主体，无实际生产经营	否

根据淄博高新产投出具的确认函，国高微（淄博）半导体制造股份有限公司目前为淄博高新产投实际控制的设备采购主体，无实际生产经营。因此，国高微（淄博）半导体制造股份有限公司与发行人不存在经营同类业务的情形。

（2）报告期内发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的企业中从事的业务与半导体行业相关的企业及其业务情况如下：

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
1	紫光国芯微电子股份有限公司	控股股东、实际控制人之一任志军曾担任该公司副董事长、总裁，于 2018 年 1 月（报告期开始前 12 个月内）卸任	集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	智能安全芯片、特种集成电路、半导体功率器件和石英晶体频率器件	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
2	紫光同芯微电子有限公司	紫光国芯微电子股份有限公司的控股子公司，报告期内该公司与发行人存在交易	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	设计、开发和销售智能安全芯片	否
3	紫光国芯微电子有限公司	控股股东、实际控制人之一任志军报告期内曾担任该公司法定代表人，该公司已于2019年2月注销	（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	设计、开发和销售智能安全芯片	否
4	重庆四联传感器技术有限公司	董事吕大龙担任该公司董事	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，其他通用仪器制造，电子测量仪器制造，其他专用仪器制造，半导体器件专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，仪器仪表批发，仪器仪表修理，电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	研发、生产高精度MEMS 压力传感器芯片	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
5	无锡沐创集成电路设计有限公司	董事吕大龙担任该公司董事	一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；软件开发；电子产品销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	设计、开发和销售高端可重构芯片及其系统解决方案	否
6	中山新诺科技股份有限公司	董事吕大龙担任该公司董事	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	数字化激光光刻设备研发、生产和销售	否
7	荣芯半导体（宁波）有限公司	董事吕大龙报告期内曾担任该公司董事	一般项目：半导体分立器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	大规模集成电路中的图像传感器（CIS）、显示驱动（TDDI/OLED DDIC）、功率器件和电源管理（MOSFET/IGBT/Charger 等）、快速闪存器（NOR FLASH）等领域的晶圆制造和晶圆级封装测试	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
8	上海沃轶致电子科技有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司执行董事兼总经理	集成电路的研究、开发和设计，计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，转让自行研发技术和设计成果，提供相关的技术支持和技术咨询服务，电子产品及设备、计算机软件（音像制品、电子出版物除外）、计算机硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	半导体 IP 及设计技术咨询	否
9	元旭半导体科技股份有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司董事	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；显示器件制造；显示器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	基于氮化镓材料的图形设计，LED 使用的蓝宝石衬底图形化	否
10	合肥芯测半导体有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司董事	半导体晶圆测试、切割、研磨、重组；半导体终端测试；半导体元件封装；软件开发；电子专用设备、测试仪器设计、制造、销售、维修；图形图像识别和处理系统研发；软件产品开发、生产；通信终端设备制造、模块设计及测试；智能消费设备制造、模块设计及测试；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	独立第三方测试（CIS 图像传感器及 MCU 微处理器等 IC 产品测试）	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
11	上海芯熠微电子有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司董事	从事电子科技，计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，电子产品、照明设备、计算机软硬件配件（除音像制品、电子出版物、计算机安全专用产品）耗材的批发、网上零售（除增值电信业务）、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的咨询、安装、维修及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	电源管理芯片设计	否
12	深圳精智达技术股份有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司董事	一般经营项目是：自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发；电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的研发、销售；计算机软件的技术开发及销售、技术咨询；自动化相关模组和器件、自动化生产技术咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的生产。	OLED 检测设备和 DRAM 老化及 CP 测试设备	否
13	上海世禹精密机械有限公司	独立董事 GAO FENG（高峰）担任该公司董事	许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事精密机械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备及其配件、金属制品、模具、五金工具、冲压件、电子产品、自动化设备的制造、销售；自有设备租赁；金属制品加工制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	IC 封装设备	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
14	上扬软件（上海）有限公司	发行人独立董事高峰担任该公司董事	计算机软件的设计、开发、制作（音像制品、电子出版物除外）、销售自产产品、并提供相关的售后服务，电子产品、芯片、测量仪器、新型仪表、通讯产品、计算机硬件研发、设计，上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	太阳能光伏及晶圆厂MES 软件系统	否
15	苏州长瑞光电有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	光电科技开发；光电集成芯片、器件、模块、设备以及软件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	激光器 VCSEL	否
16	同源微（北京）半导体技术有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；软件开发；销售电子产品、机械设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	高性能 X 射线探测器产品和模块	否
17	上海伟测半导体科技股份有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准	晶圆测试和芯片成品测试服务	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
			文件或许可证件为准)		
18	强一半导体（苏州）股份有限公司	发行人监事祁耀亮担任该公司董事	研发、加工、生产、销售：半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	研发、设计、制造和组装半导体测试解决方案产品（集成电路晶圆测试探针卡）	否
19	成都启英泰伦科技有限公司	发行人监事祁耀亮担任该公司董事	开发、销售集成电路、计算机软硬件、电子产品；软件技术开发、技术转让；信息系统集成；信息技术咨询、技术服务；数据处理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。	物联网人工智能芯片及相关集成电路设计和配套应用解决方案	否
20	京微齐力（北京）科技有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；集成电路设计、芯片设计、软件设计、产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	FPGA 芯片	否
21	上海季丰电子股份有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事集成电路、半导体科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件的开发、销售，电子产品、电子元器件、模具、仪器仪表、计算机硬件及辅	测试载板、测试服务及测试设备	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
			助设备、机电设备的销售、租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
22	昇显微电子（苏州）有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	电子产品、电子元器件、通信产品、计算机软硬件、集成电路的研发、设计、委托生产和销售；并提供以上产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	智能手机和智能穿戴设备 AMOLED 驱动芯片	否
23	昆腾微电子股份有限公司	监事祁耀亮担任该公司董事	集成电路、半导体、半导体元器件的设计、研发和委托加工；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	模拟集成电路	否
24	睿晶半导体（宁波）有限公司	发行人监事祁耀亮担任该公司执行董事兼总经理	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（半导体光掩模板）	否
25	睿晶微（上海）半导体有限公司	发行人监事祁耀亮担任该公司执行董事兼总经理	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	电子专用材料研发；电子专用材料销售（半导体光掩模板）	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
26	泓沅（苏州）半导体科技有限公司	发行人监事祁耀亮担任该公司董事	半导体光电设备及零部件、机械设备及配件、净化设备及配件、电子仪器及配件、无尘室设备及配件、智能机器人及配件的销售、组装、上门安装及维修、技术咨询服务；机电工程、智能化系统工程的设计及施工；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：石墨及碳素制品销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；技术玻璃制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	晶圆传输设备研发、生产、销售和售后； 半导体设备机械手臂翻新维护	否
27	美芯晟科技（北京）股份有限公司	监事祁耀亮报告期内曾担任该公司董事	研发电子元器件、计算机软硬件；系统集成；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	LED 芯片和无线充电芯片	否
28	山东齐桓智能设备有限公司	董事陈铎实际控制的公司	一般项目：半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；模具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	电镀压板模具与蚀刻框架生产设备研发、生产和销售	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
29	山东开名机电有限公司	董事陈铎实际控制的公司	一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	电镀压板模具与蚀刻框架生产设备研发、生产和销售	否
30	山东凡勋电子设备有限公司	董事陈铎间接控制的公司	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；模具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2021年10月9日成立，目前尚无实际业务	否
31	恒汇电子	发行人董事陈铎之父陈同胜实际控制的公司	报告期开始时为：IC卡封装框架、计算机软硬件及外部设备生产、销售；IC软件开发、承接IC卡应用工程施工；房地产销售；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2020年8月变更为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	原生产IC卡封装框架，2018年1月起已停止经营	否

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
32	凯胜股份	发行人董事陈铎之父陈同胜实际控制的公司	报告期开始时为：集成电路卡芯片与模块、计算机软硬件生产、销售、技术开发、技术服务；集成电路及相关产品的设计、研究、开发与应用，承接 IC 卡应用工程，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2021 年 7 月变更为：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	原从事集成电路卡芯片与模块生产、销售业务，2018 年 1 月起已停止经营	否
33	淄博恒汇销售	发行人董事陈铎之父陈同胜实际控制的公司（2022 年 8 月已注销）	报告期开始时为：IC 卡封装框架、IC 卡芯片及模块、计算机软硬件（不含计算机信息系统安全专用产品）及外部设备销售；IC 软件开发、承接 IC 卡应用工程施工，货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2021 年 12 月变更为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	原为恒汇电子销售公司，从事 IC 卡封装框架、IC 卡芯片与模块销售业务；2018 年已停止经营	否
34	淄博凯胜销售	发行人董事陈铎之父陈同胜实际控制的公司（2022 年 8 月已注销）	报告期开始时为：IC 卡芯片与模块、计算机软硬件销售、技术开发、技术服务；集成电路及相关产品的设计、研发与应用；承接 IC 卡应用工程；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2021 年 12 月变更为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	原为凯胜股份销售公司，从事 IC 卡芯片与模块销售业务；2018 年已停止经营	否

如上表所示，发行人从事的业务与半导体行业相关的关联方中存在以下企业涉及封装测试业务，但细分领域与发行人明显不同，不存在与发行人经营同类业务的情形，相关情况如下：

荣芯半导体（宁波）有限公司主营业务为大规模集成电路中的图像传感器（CIS）、显示驱动（TDDI/OLED DDIC）、功率器件和电源管理（MOSFET/IGBT/Charger 等）、快速闪存器（NOR FLASH）等领域的晶圆制造和晶圆级封装测试，与发行人从事的智能卡模块封装测试存在较大差异，与发行人不属于同类业务，与发行人不构成同业竞争情形。

合肥芯测半导体有限公司主要从事 CIS 图像传感器及 MCU 微处理器等 IC 产品测试，与发行人从事的智能卡模块封装测试存在较大差异，与发行人不属于同类业务，与发行人不构成同业竞争情形。

上海伟测半导体科技股份有限公司（股票代码：688372，以下简称“伟测科技”）主要从事晶圆测试和芯片成品测试服务，其提供测试服务的晶圆和成品芯片类型主要为 CPU、MCU、FPGA、SoC 芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等。发行人从事的智能卡模块封装测试仅针对智能卡，相关的应用领域如电信卡、银行卡、社保卡等。因此，伟测科技与发行人不属于同类业务，与发行人不构成同业竞争情形。

上海季丰电子股份有限公司主要从事集成电路可靠性认证测试，测试载板、硬件软件方案、特种封装测试、仪器设备研发。其中的特种封装测试即快封（封装样品），涉及到的封装品种主要为 COB（chip on board）和陶瓷封装，快封后再对样品做芯片失效分析、可靠性测试等，与发行人从事的智能卡模块封装测试存在较大差异，与发行人不属于同类业务，与发行人不构成同业竞争情形。

发行人董事陈铎之父陈同胜实际控制的恒汇电子、凯胜股份原分别从事 IC 卡封装框架及智能卡模块封测服务业务，淄博恒汇销售、淄博凯胜销售系上述两家公司的销售公司，发行人重组设立后，独立开展生产及销售，重组完成后，上述企业均已在 2018 年停止经营。因此，恒汇电子、凯胜股份及其销售公司不存在经营与发行人同类业务的情形，亦不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争的情形。

除此以外，其他从事业务与半导体行业相关的关联企业与发行人业务明显不同，不存在与发行人经营同类业务的情况。

（3）报告期内与发行人有一定关系且存在交易，比照关联方披露的企业中从事的业务与半导体行业相关的企业及其业务情况如下：

序号	企业名称	关联关系	经营范围	主营业务	是否与发行人经营同类业务
1	江西萨瑞微电子技术有限公司	发行人持股 5%以上 股东武岳峰投资并派驻董事的上海维安电子有限公司对该公司投资并派驻了董事	微电子技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；集成电路设计、集成电路芯片制造；半导体分立器件、通讯器材、机电产品设备的研发、制造及加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	从事集成电路设计、集成电路芯片制造、半导体分立器件制造及加工和销售	否
2	江西萨瑞半导体技术有限公司	系江西萨瑞微电子技术有限公司控股的公司	许可项目：技术进出口，进出口代理，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	半导体分立器件制造、销售及加工业务	否
3	上海原陆微电子科技有限公司	该公司实际控制人王俊持有发行人股东无锡利戈 20.00%的出资份额	一般项目：微电子技术、环保科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；信息系统集成服务；贸易经纪；销售电子设备、集成电路、计算机软硬件及辅助设备、通信设备。（除依法须经批准的项目外开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	代理销售胶带等半导体封装材料及备件	否
4	上海安琴智能科技有限公司	公司外部顾问宋光明持股 20%的公司	从事智能化、计算机信息（除互联网信息服务）、电子科技领域内技术开发、技术咨询，电子产品，塑料制品，包装材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），办公设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），办公文化用品，通讯器材，通信设备及相关产品销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	智能卡模块等半导体材料贸易销售	否

江西萨瑞微电子有限公司从事集成电路设计、集成电路芯片制造、半导体分立器件制造及加工和销售；其控股的江西萨瑞半导体技术有限公司从事半导体分立器件制造、销售及加工业务，与发行人所处半导体细分领域明显不同，不属于与发行人经营同类业务的情形。

上海原陆微电子科技有限公司从事胶带等半导体封装用材料及备件的贸易、备件维修，同时代理发行人的蚀刻引线框架产品，主要对华天科技（西安）有限公司和华天科技（南京）有限公司进行销售，其业务与发行人明显不同，不属于与发行人经营同类业务的情形。

上海安琴智能科技有限公司主要从事智能卡模块等半导体材料的贸易，其主要客户为卡商，如东莞市卡的智能科技有限公司、深圳市明华澳汉智能卡有限公司等，与发行人的主要客户不存在重叠。上海安琴智能科技有限公司不存在与发行人经营同类业务的情形。

除上述企业以外，发行人其他关联方的经营范围中未涉及半导体相关业务，其主营业务与发行人的业务领域不同，不存在经营同类业务的情形。

（二）核查方式

1、查阅发行人控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员填写的调查表；查阅祁耀亮、高峰、吕大龙等关联方出具的关于其关联企业业务情况的确认函；查阅发行人控股股东、实际控制人之一虞仁荣控制的半导体行业相关企业韦尔股份出具的关于业务情况及与新恒汇客户和供应商重叠情况的说明；

2、通过国家企业信用信息公示系统查询发行人关联方的企业基本信息及经营范围；通过（拟）上市公司的信息披露及其他公开信息核查发行人关联方的主要业务情况；

3、取得发行人出具的关于与关联方伟测科技等不存在经营同类业务的情况说明；

4、取得发行人控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函。

（三）核查意见

本所律师认为：发行人的部分关联方存在从事半导体行业相关业务的情形，但半导体行业分工很细，该等关联方提供的细分产品或服务与发行人显著不同，故发行人与关联方之间不存在经营同类业务的情形，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

四、第二轮审核问询函之 5.关于主要客户紫光同芯

申请文件及首轮问询回复显示：

（1）报告期各期，发行人第一大客户均为紫光同芯，向其销售金额分别为 14,199.47 万元、7,391.97 万元、8,047.72 万元和 5,165.99 万元，其中智能卡模块销售金额分别为 10,703.12 万元、6,474.98 万元、5,480.71 万元和 4,638.55 万元，柔性引线框架销售金额分别为 3,490.52 万元、900.51 万元、1,980.42 万元和 10.43 万元，2022 年 1-6 月大幅下降。（2）2022 年 6 月末，发行人其他应付款主要为紫光同芯预付智能卡模块产品产能 3,600 万元保证金。请发行人：（1）说明 2022 年 1-6 月向紫光同芯销售的智能卡模块收入增加而柔性引线框架大幅减少的原因。（2）说明紫光同芯 2022 年向发行人预付 3,600 万元保证金的背景及原因，其他客户是否有类似情况，是否存在特殊利益安排。请保荐人、申报会计师发表明确意见，请发行人律师对问题（2）发表明确意见。

回复：

（一）说明紫光同芯 2022 年向发行人预付 3,600 万元保证金的背景及原因，其他客户是否有类似情况，是否存在特殊利益安排

1、紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）预付保证金的背景及原因

2022 年以来，紫光同芯调整了销售策略，大幅减少对外销售安全芯片（晶圆裸片）数量，更多的是将安全芯片封装成智能卡模块后再对外出售，因此紫光同芯对智能卡模块封测的需求量大幅增长。但国内可以满足紫光同芯要求的智能卡模块封装厂商的产能有限，扩产周期长；同时，2022 年上半年上海的新冠疫情封控对坐落于上海的隶属于法国 Linxens 的智能卡模块封装厂商的生产经营活动又产生了一定的影响，导致紫光同芯对智能卡模块产能的需求得不到满足。为此，紫光同芯希望发行人增加智能卡模块封装产能从而保障其订单需求，而发行

人担忧产能增加后，一旦上海新冠疫情平稳，紫光同芯的智能卡模块封装订单可能会减少，导致公司智能卡模块封测业务产能利用率下降和资源浪费。

经双方协商，紫光同芯愿意与发行人签署《战略合作协议》，并支付一定的保证金来预定发行人的智能卡模块封测产能，以体现长期业务合作的诚意。

在此背景下，紫光同芯基于其销售策略变化和采购需求规划，于 2022 年 6 月与发行人签署了《战略合作协议》，协议主要条款约定如下：

（1）紫光同芯承诺，为满足其产品的采购需求，愿意提供 3,600 万元的保证金作为履行协议所承诺义务的保证。同时，紫光同芯的产品采购业务尽力按月进行计划，每月需求数量相对合理，不出现集中交付的要求，具体以届时双方认可的订单约定为准；

（2）发行人保证将尽商业上合理的努力满足紫光同芯的预期需求，提前安排产能预定；如遇形势变化或其他不可抗力影响生产计划，双方可以友好协商推迟产能保障；

（3）双方根据市场状况，以互利共赢原则，友好协商产品价格，产品价格以发行人最终报价为准；

（4）紫光同芯提供的上述保证金应当在全额到达发行人账户之日起最迟一年内，由发行人及时无息全额一次性返还给紫光同芯，具体返还日期由双方书面协商确定。若紫光同芯书面提出返还上述保证金的，发行人应当按照紫光同芯要求在 30 日内全额返还；若未及时返还，按照同期中国人民银行商业贷款利率支付利息；

（5）协议于 2022 年 6 月 20 日生效，有效期一年，其约束力不受双方之间的其他合作协议期满或终止的影响。

2022 年 6 月 29 日，紫光同芯根据《战略合作协议》向发行人支付了 3,600 万元保证金。

2、其他客户不存在类似情况

根据公司出具的说明，报告期内，除紫光同芯外，公司其他客户不存在类似预付保证金的情况。

3、紫光同芯预付保证金不存在特殊利益安排

紫光同芯预付保证金是基于其销售策略和采购需求规划所作的安排，公司合理满足其预期需求，提前安排产能预定，预定产能预付保证金具有一定的商业合理性，不存在特殊利益安排。

由于双方业务合作进展顺利，发行人的产能增加与紫光同芯的订单相匹配，紫光同芯已根据双方签署的《战略合作协议》向公司申请退还上述保证金，公司于2022年12月5日向紫光同芯退还了3,600万元保证金。

（二）核查方式

1、获取发行人与紫光同芯签署的《战略合作协议》，核查主要协议条款及是否存在特殊利益安排；取得紫光同芯的《保证金退还申请书》及发行人的退款凭证，了解保证金处置情况；

2、访谈发行人董事长，了解紫光同芯预付保证金的背景及商业合理性，并取得发行人出具的书面说明。

（三）核查意见

本所律师认为：报告期内，紫光同芯向发行人预付保证金具有商业合理性，不存在特殊利益安排；其他客户不存在类似情况。

本《补充法律意见书（三）》正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

负责人：

顾功耘

经办律师：

徐万辉

经办律师：

黄夏敏

经办律师：

陈慧

2022年12月16日